

---

**Bipolartransistor mit erhöhtem Basisanschlussgebiet  
und Verfahren zu seiner Herstellung**

---

Die Erfindung bezieht sich auf einen Bipolartransistor mit erhöhtem Basisanschlussgebiet sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung.

Die vorliegende Anmeldung bezieht durch Referenznahme die deutsche Patentanmeldung DE 103 58 046.8, deren Priorität zugleich beansprucht wird,

5       vollständig mit ein.

Bipolartransistoren werden in vielfältiger Weise in integrierten analogen und digitalen elektronischen Schaltungen eingesetzt. Insbesondere werden Bipolartransistoren wegen ihrer kurzen Schaltzeiten für Hochgeschwindigkeitsanwendungen genutzt. Die Leistungsfähigkeit von Bipolartransistoren im Hochgeschwindigkeitsbereich konnte durch eine vertikale und laterale Skalierung der Transistordimensionen und durch die Einführung epitaxial hergestellter Basisschichten erheblich gesteigert werden.

Dazu hat insbesondere die Entwicklung von Heterobipolartransistoren beige-  
tragen. Bei Heterobipolartransistoren bestehen die Emitter- und Basisschicht  
aus unterschiedlichen Halbleitermaterialien, wobei der Emitter eine größere  
Bandlücke besitzt als die Basis. Ein Beispiel dafür sind SiGe-  
5 Heterobipolartransistoren, bei denen der Emitter aus Silizium (Si) besteht und  
die Basis eine Silizium-Germanium-Legierung (SiGe) enthält.

Die Hochfrequenzeigenschaften moderner Bipolartransistoren werden bei zu-  
nehmender Skalierung durch die Widerstände von Basis, Emitter und Kollek-  
tor sowie durch parasitäre Basis-Emitter- und Basis-Kollektor-Kapazitäten limi-  
10 tiert. Insbesondere kann durch eine Reduktion des Basiswiderstandes die  
Grenzfrequenz der Leistungsverstärkung gesteigert werden. Diese Grenzfre-  
quenz wird als  $f_{max}$  bezeichnet. Darüber hinaus führt eine Reduktion des Ba-  
siswiderstandes zu einer Verbesserung der Rauscheigenschaften des Tran-  
sistors.

15 Der konventionelle Weg zur Reduzierung des Basiswiderstandes ist eine Io-  
nenimplantation in die extrinsische Basisregion, die nachfolgend auch als äu-  
ßerer Basisabschnitt oder äußeres Basisgebiet bezeichnet wird (englisch:  
extrinsic base region). Derartig hergestellte Transistoren haben den Nachteil,  
dass bei der Ionenimplantation entstehende Implantationsschäden zu einer  
20 verstärkten Diffusion der Dotieratome führen und dadurch letztlich die Leis-  
tungsfähigkeit der Transistoren begrenzen. Figur 1 zeigt die extrinsische und  
die intrinsische Basisregion in einer Draufsicht auf einen Bipolartransistor.

Ein alternatives Konzept zur Reduzierung des Basiswiderstandes unter Ver-  
meidung von Implantationsschäden ist die Verstärkung der Basisschicht durch  
25 eine zusätzliche Halbleiterschicht im äußeren Basisabschnitt. Nach dem be-  
kanntem Stand der Technik gibt es zwei alternative Zugänge zur Realisierung  
derartiger verstärkter Basisanschlusschichten:

- (1) Herstellungsverfahren, die auf selektiver Epitaxie des inneren Basis-  
schichtabschnitts beruhen. Der innere Basisschichtabschnitt, nachfolgend

auch intrinsische Basisschicht, intrinsische Basisregion oder intrinsisches Basisgebiet genannt, bildet den Bereich der Basis, der im lateralen Bereich des Emitterfensters unter diesem angeordnet ist. Herstellungsverfahren mit selektiver Epitaxie nutzen üblicherweise eine vor der Abscheidung des inneren Basisabschnitts hergestellte Poly-Siliziumschicht als Basisanschluss. Ein derartiger Transistor wurde von Yamazaki in US 5,523,606 beschrieben. Mittels selektiver Epitaxie wird eine Basisschicht auf freigelegte Teile der Substratoberfläche und in Hohlräume abgeschieden, die durch die Substratoberfläche und Überhänge der als Basisanschluss dienenden Poly-Siliziumschicht gebildet werden. Ein wesentlicher Nachteil dieser Konstruktion ist die schlechte Prozesskontrolle für die selektive Abscheidung unterhalb der überhängenden Poly-Siliziumschicht. Darüber hinaus führt die Abscheidung der intrinsischen Basis unterhalb der überhängenden Basisanschlusssschicht zu einer Vergrößerung der Fläche des Basis-Kollektor-Übergangs, wodurch die Basis-Kollektor-Kapazität erhöht wird. Diese konstruktiven Einschränkungen führen letztendlich zu einer Limitierung der Hochfrequenzparameter.

- (2) Ahlgren et al., US 6,492,238, haben die Herstellung einer erhöhten Basisanschlussregion mittels Chemisch-Mechanischer-Politur (CMP) beschrieben. Der entsprechende Transistoraufbau ist in Figur 2 skizziert. Entsprechend US 6,492,238 hergestellte Transistoren besitzen eine epitaxiale Basisschicht 101 und einen erhöhten äußeren Basisabschnitt 102. Der Emitter 103 ist von dem erhöhten äußeren Basisabschnitt 102 durch die Isolationsschicht 106 sowie durch eine innere Abstandsschicht (Spacer) 104 und eine äußere Abstandsschicht 105 getrennt. Ein Nachteil dieser Konstruktion besteht darin, dass die durch den Doppelspacer 104/105 gebildete Isolation zwischen Emitter und erhöhtem äußerem Basisabschnitt an der Grenze epitaxialen Basisschicht 101 ihre größte Breite besitzt. Diese Konstruktion erweist sich als nachteilig bei der gemeinsamen Minimierung von Basiswiderstand und Basis-Emitter-Kapazität und bewirkt damit Einschränkungen der Hochfrequenzparameter. Weiterhin ist die Wahl der Dicke der Isolationsschicht 106 durch die Toleranzen der

bekannten CMP-Verfahren eingeschränkt. Eine zu große Dicke der Isolationsschicht 106 kann zu erhöhten Emitterwiderständen führen. Weiterhin wird durch die zweifache Anwendung von CMP-Verfahren entsprechend US 6,492,238 die Komplexität des Herstellungsprozesses wesentlich erhöht.

5

- (3) Aus der EP 0949 665 A2 ist ein Bipolartransistor bekannt, bei dem der äußere Basisabschnitt durch Diffusion von Bor aus einer hochdotierten Polysiliziumschicht in das darunter liegende einkristalline Silizium gebildet wird. Nach außen hin liegt diese hochdotierte Polysiliziumschicht auf einer Isolatorschicht auf. Ein Abstandshalter trennt die Polysiliziumschicht vom Emitter, der in etwa T-förmig ausgebildet ist. Der innere Basisabschnitt wurde durch Ionenimplantation hergestellt. Nachteilig für die Hochfrequenzeigenschaften der dort beschriebenen Transistorstruktur ist zum einen die große Eindringtiefe des eindiffundierten äußeren Basisabschnitts in das einkristalline Silizium, die für einen niederohmigen Anschluss des inneren Basisabschnitts notwendig ist. Dadurch wird die Basis-Kollektor-Kapazität erhöht.

10

15

20

Gegenüber dem bekannten Stand der Technik stellt sich das technische Problem, einen Bipolartransistor mit geringem Basiswiderstand anzugeben, der mit geringem Aufwand herstellbar ist und bei dem Basis und Emitter im Hinblick auf eine gute Hochfrequenztauglichkeit des Bipolartransistors verbessert werden.

Dieses Problem wird durch einen Bipolartransistor nach Anspruch 1 sowie ein Verfahren nach Anspruch 18 und ein Verfahren nach Anspruch 20 gelöst.

25

Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass es gelingt, den Basiswiderstand zu verringern, wenn die Abstandsschicht zwischen Emitter und dem äußeren Basisabschnitt in ihrer lateralen Erstreckung (Breite) an der Grenze zum inneren Basisabschnitt schmal ausgebildet wird. Die Erfindung schließt zugleich die Erkenntnis ein, dass andererseits eine zu geringe mittlere Breite der Ab-

standsschicht nachteilige Auswirkungen auf die Basis-Emitter-Kapazität hat. Ein Nachteil der beschriebenen vorbekannten Konstruktionen besteht demnach insbesondere darin, dass die Isolation zwischen Emitter und äußerer Basisschicht an der Grenze zur inneren Basisschicht eine große, zum Teil 5 sogar ihre größte Breite besitzt. Dies bedingt im Licht der vorliegenden Erfindung einen unnötig erhöhten Basiswiderstand.

Die Grundidee der Erfindung ist es, die laterale Erstreckung des Abstandshalters (engl. Spacer) zwischen Emitter und äußerem Basisabschnitt an seiner Grenzfläche zum inneren Basisabschnitt möglichst gering zu halten und mit 10 zunehmender Höhe über dem inneren Basisabschnitt wachsen zu lassen.

Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird das technische Problem daher gelöst durch einen Bipolartransistor auf einem Substrat, umfassend eine Basis mit einem inneren Basisabschnitt und einem äußeren Basisabschnitt, der an den inneren Basisabschnitt in zur Substratoberfläche paralleler, lateraler Richtung angrenzt und in einer senkrecht zur Substratoberfläche weisenden Höhenrichtung eine größere Erstreckung hat als der innere Basisabschnitt, einen Emitter mit einem T-förmigem Querschnittsprofil, der vom äußeren Basisabschnitt lateral durch einen Abstandshalter aus Isolatormaterial getrennt ist und dessen dem vertikalen T-Balken entsprechender Abschnitt mit seinem unteren Ende in Höhenrichtung an den inneren Basisabschnitt (4a) angrenzt. 15 20

Bei dem erfindungsgemäßen Bipolartransistor nimmt die laterale Erstreckung des Abstandshalters zwischen dem Emitter und dem äußerem Basisabschnitt unterhalb eines dem horizontalen T-Balken entsprechenden Abschnitt des Emitters ausgehend von der Grenzfläche des Abstandshalters zum inneren Basisabschnitt mit zunehmender Höhe über dem inneren Basisabschnitt zu. 25 Die Zunahme der lateralen Erstreckung des Abstandshalters erfolgt in der Weise, dass eine von Emitter und Abstandshalter gebildete erste Grenzfläche unter einem ersten, entweder rechten oder stumpfen Winkel auf eine von 30 Emitter und innerem Basisabschnitt gebildete zweite Grenzfläche stößt und

eine vom Abstandshalter und dem äußeren Basisabschnitt gebildete dritte Grenzfläche auf die zweite Grenzfläche unter einem zweiten stumpfen Winkel stößt, der größer ist als der erste Winkel. Auf diese Weise wird zum einen bewirkt, dass der Basiswiderstand des Bipolartransistors einen möglichst gerin-  
5 gen Wert annimmt. Denn durch die minimale laterale Erstreckung des Ab- standshalters an seiner unteren Grenzfläche, also der Grenzfläche zum inneren Basisabschnitt, wird die laterale Erstreckung des durch eine geringere Dotierung und einen höheren Schichtwiderstand gekennzeichneten inneren Basisabschnitts minimiert und ein geringer Basiswiderstand des Transistors  
10 realisiert. Andererseits bewirkt die in Höhenrichtung zunehmende laterale Erstreckung des Abstandshalters, dass die parasitäre Kapazität zwischen dem Emitter und dem erhöhten äußeren Basisabschnitt möglichst gering ist.

Mit der erfindungsgemäßen Lösung wird ein Kompromiss zwischen der Minimierung des Basiswiderstandes und der Minimierung der parasitären Ba-  
15 sis-Emitter-Kapazität geschaffen, der im Ergebnis im Vergleich mit vorbekannten Lösungen zu einer Verbesserung der Hochfrequenzeigenschaften des erfindungsgemäßen Bipolartransistors führt.

Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen Bipolar- transistors beschrieben.

20 Die minimale laterale Erstreckung des Abstandshalters beträgt an der Grenzfläche zum inneren Basisabschnitt vorzugsweise zwischen 5 und 80 nm. Weiter bevorzugt ist das Intervall zwischen 10 und 60 nm. Besonders bevor-  
zugt ist das Intervall zwischen 15 und 50 nm. Die minimale laterale Erstreckung sollte im Sinne eines Kompromisses zwischen Basiswiderstand und  
25 Basis-Emitter-Kapazität nicht zu gering gewählt werden.

Die Zunahme der lateralen Erstreckung des Abstandshalters erfolgt vorzugs- weise kontinuierlich.

In einer alternativen Ausführungsform erfolgt die Zunahme der lateralen Erstreckung des Abstandshalters stufenweise. Bei einer stufenweisen Zunahme entsprechen die Stufen sehr geringen Höhenschritten, die weit geringer als die Höhendifferenz von innerem und äußerem Basisabschnitt sind. Auch bei einer 5 stufenförmigen Zunahme stößt eine von Emitter und Abstandshalter gebildete erste Grenzfläche unter einem ersten, entweder rechten oder stumpfen Winkel auf eine von Emitter und innerem Basisabschnitt gebildete zweite Grenzfläche, und eine vom Abstandshalter und dem äußeren Basisabschnitt gebildete dritte Grenzfläche auf die zweite Grenzfläche unter einem zweiten 10 stumpfen Winkel, der größer ist als der erste Winkel. Dabei kann jedoch nicht die gesamte Grenzfläche zwischen Emitter und Abstandshalter bzw. zwischen Abstandshalter und äußerem Basisabschnitt zur Bestimmung des Winkels herangezogen werden, sondern jeweils nur ein oder mehrere Teilbereiche dieser Grenzflächen, zu denen jedenfalls der Bereich unmittelbar an der 15 Grenzfläche von Emitter und innerem Basisabschnitt zählt.

- Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel stößt die von Emitter und Abstandshalter gebildete erste Grenzfläche unter einem stumpfen ersten Winkel ( $\alpha$ ) auf die von Emitter und innerem Basisabschnitt gebildete zweite Grenzfläche. Der stumpfe Winkel  $\alpha$  beträgt vorzugsweise zwischen  $100^\circ$  und  $135^\circ$ .  
20 Die Zunahme der lateralen Erstreckung des Abstandshalters mit wachsender Höhe über dem inneren Basisabschnitt wird vorzugsweise so realisiert, dass eine von Abstandshalter und äußerem Basisabschnitt gebildete dritte Grenzfläche auf die zweite Grenzfläche unter einem zweiten stumpfen Winkel stößt, der größer ist als der erste stumpfe Winkel.  
25 Um bei diesem Ausführungsbeispiel eine Zunahme der lateralen Erstreckung des Abstandshalters zu bewirken, muss der zweite stumpfe Winkel einen Betrag haben, der größer ist als der des ersten stumpfen Winkels. Vorzugsweise beträgt der zweite stumpfe Winkel unter Beachtung dieser Randbedingung  $180^\circ - \beta$ , wobei  $\beta$  zwischen  $40^\circ$  und  $75^\circ$  beträgt.

In einem alternativen Ausführungsbispiel ist der erste Winkel ein rechter Winkel. Die Zunahme der lateralen Erstreckung des Abstandshalters wird in diesem Ausführungsbeispiel dadurch realisiert, dass die vom Abstandshalter und dem äußeren Basisabschnitt gebildete dritte Grenzfläche auf die zweite 5 Grenzfläche unter einem zweiten stumpfen Winkel stößt. Vorzugsweise beträgt auch bei diesem Ausführungsbeispiel der zweite stumpfe Winkel  $180^\circ - \beta$ , wobei  $\beta$  zwischen  $40^\circ$  und  $75^\circ$  beträgt.

Bevorzugt ist der innere Basisabschnitt einkristallin ausgebildet. Auf diese Weise werden besonders gute Hochfrequenzparameter erzielt.

10 In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann der laterale Abstandshalter in Höhenrichtung einen oder mehrere weitere Schichtabschnitte aufweisen, deren Grenzfläche mit dem Emitter einen stumpfen Winkel aufweisen, der größer als  $\alpha$  ist. Weiterhin kann der Abstandshalter aus einem Stapel mehrerer Schichtabschnitte bestehen; deren laterale Erstreckung mit zunehmender 15 Höhe über dem inneren Basisabschnitt zunimmt.

Die Ausbildung eines erhöhten äußeren Basisabschnitts ist prozesstechnisch besonders einfach mit einer Konstruktion zu bewerkstelligen bei der die Basis eine erste Basisschicht und eine zweite, auf der ersten aufliegende Basisschicht enthält, wobei die zweite Basisschicht im lateralen Bereich des inneren 20 Basisabschnitts zur Bildung eines Emitterfensters zumindest teilweise geöffnet ist.

Vorzugsweise hat die zweite Basisschicht oder haben beide Basisschichten im äußeren Basisabschnitt zur Reduzierung des Basiswiderstands eine im Vergleich zum inneren Basisabschnitt erhöhte Dotierstoffkonzentration, wobei 25 die höhere Dotierstoffkonzentration auf einen Höhenabschnitt oberhalb eines Maximums der Dotierstoffkonzentration im inneren Basisabschnitt beschränkt ist. Die Beschränkung der Hochdotierung auf den Bereich oberhalb des Maximums der Dotierung des inneren Basisabschnitts dient der Vermeidung erhöhter Basis-Kollektor-Kapazitäten. Die Dotierstoffkonzentration in der zwei-

ten Basisschicht kann oberhalb von  $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  liegen und ist vorzugsweise vom gleichen Leitungstyp wie die der epitaxialen ersten Basisschicht. Besonders bevorzugt ist eine Dotierstoffkonzentration der zweiten Basisschicht zwischen  $2 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  und  $2 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ .

- 5 Ein besonders geringer Basiswiderstand wird bei einem Bipolartransistor erreicht, bei dem der äußere Basisabschnitt den inneren Basisabschnitt lateral umgibt an mehreren oder allen vier Seiten umgibt.

Um eine Diffusion des Dotierstoffes aus der hochdotierten erhöhten Basisschicht in benachbarte Abschnitte des Transistors und damit eine Ausdehnung 10 des Basisgebiets zu verhindern, sind der innere Basisabschnitt oder der äußere Basisabschnitt oder beide Basisabschnitte zusätzlich mit Kohlenstoff dotiert. Die Kohlenstoffkonzentration beträgt vorzugsweise zwischen  $5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$  und  $5 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ . Besonders bevorzugt ist eine Kohlenstoffkonzentration zwischen  $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  bis  $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ .

- 15 In einem weiteren Ausführungsbeispiel besteht die zweite Basisschicht ganz oder teilweise aus einer Silizium-Germanium-Legierung. Dadurch wird eine weitere Reduzierung des Basiswiderstandes durch eine weitere Erhöhung der Dotierung möglich.

Zur Erzielung eines besonders geringen Emitterwiderstands weist der Emitter 20 ein T-förmiges Querschnittsprofil auf. Dabei liegt der dem horizontalen T-Balken entsprechende Emitterabschnitt oberhalb des äußeren Basisabschnitts. Der dem horizontalen T-Balken entsprechende Abschnitt des Emitters ist in einem bevorzugten Ausführungsbeispiel durch einen zweiten Abstandshalter aus Isolatormaterial vom darunter liegenden äußeren Basisabschnitt getrennt. Die lateralen Enden des dem horizontalen T-Balken 25 entsprechenden Abschnitts des Emitters können durch einen dritten Abstandshalter aus Isolatormaterial von dem lateral unterhalb angrenzenden äußeren Basisabschnitt getrennt werden. Beide Maßnahmen dienen der Verringerung der Basis-Emitter-Kapazität.

Die Wahl des Isolatormaterials zur Verwendung in den Isolatorregionen zwischen Emitter äußerem Basisabschnitt ist grundsätzlich frei. Vorzugsweise wird das prozesstechnisch sehr gut beherrschbare Siliziumdioxid  $\text{SiO}_2$  verwendet. Aber grundsätzlich ist zur weiteren Optimierung auch eine Verwendung anderer Isolatormaterialien denkbar. Zur Erzielung einer möglichst geringen Basis-Emitter-Kapazität ist die Verwendung eines Isolatormaterials mit geringerer Dielektrizitätszahl  $\epsilon$  als Siliziumdioxid denkbar. Eine solche Maßnahme würde es erlauben, die laterale Erstreckung des Abstandshalters an der Grenzfläche zum inneren Basisabschnitt zu verringern, ohne dass die Basis-Emitter-Kapazität über den Wert hinausginge, der sich bei einer Verwendung von  $\text{SiO}_2$  einstellen würde.

Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren zur Herstellung eines Bipolartransistors bereitgestellt. Das Verfahren kann im Rahmen eines Bipolar- oder eines BiCMOS-Prozesses eingesetzt werden und weist die folgenden Schritte auf:

- a) Abscheiden eines Schichtstapels auf einer epitaxialen Basisschicht, der mindestens eine später zu entfernende Hilfschicht und eine erste Isolatorschicht (6) enthält,
- b) Öffnung des Emitterfensters durch abschnittsweises Entfernen des Schichtstapels,
- c) Abscheiden einer zweiten-Isolatorschicht und
- d) Strukturieren der zweiten Isolatorschicht, derart, dass am Rand des Emitterfensters ein Abstandshalter aus Isolatormaterial entsteht, dessen laterale Erstreckung (d) ausgehend von seiner Grenzfläche zur epitaxialen Basisschicht mit zunehmender Höhe über der epitaxialen Basisschicht zunimmt,

- e) Abscheiden einer Emitterschicht, im Emitterfenster und auf der zweiten Isolatorschicht sowie Ausbildung eines im Quer-schnittsprofil T-förmigen Emitters durch laterale Strukturierung der Emitterschicht sowie Ausbildung von Spacern aus Isolatormaterial an den Seitenflächen des Emitters,
- f) Freilegen der Halbleiteroberfläche der Basisschicht in den lateralen Bereichen des äußeren Basisabschnitts und Abscheiden einer erhöhten Basisanschlusschicht auf diesen Gebieten.

Die in den letzten drei Absätzen d), e) und f) genannten Schritte werden erfindungsgemäß so durchgeführt, dass eine von Emitter und Abstandshalter gebildete erste Grenzfläche unter einem ersten, entweder rechten oder stumpfen Winkel auf eine von Emitter und innerem Basisabschnitt gebildete zweite Grenzfläche stößt, und dass eine vom Abstandshalter und der erhöhten Basisanschlusschicht im äußeren Basisabschnitt gebildete dritte Grenzfläche auf eine von Abstandshalter und innerem Basisabschnitt gebildete die zweite Grenzfläche unter einem zweiten stumpfen Winkel stößt, der größer ist als der erste Winkel.

Die Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben sich unmittelbar aus der obigen Darstellung der Vorteile des erfindungsgemäßen Bipolartransistors. Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen Verfahrens beschrieben.

- Darüber hinaus ist ein Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens, dass es ein zum Emitterfenster selbstjustierendes Abscheiden eines erhöhten Basisanschlussgebiet ermöglicht.
- Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbeispiel weist die folgenden Schritte bis zum Schritt des Ausbildens des Emitterfensters auf:

- Bereitstellung eines präparierten Substrates, auf dem mindestens ein aktives Bipolartransistorgebiet und optional zusätzlich mindestens ein aktives CMOS-Gebiet definiert ist,
- Abscheiden einer Hilfsschicht auf dem präparieren Substrat und Öffnen 5 eines Fensters in der Hilfsschicht über dem aktiven Bipolartransistorgebiet,
- Abscheiden einer epitaxialen Basisschicht, in die eine Basisdotierung in-situ eingebracht wird.

Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung wird ein alternatives Verfahren zur 10 Herstellung des Bipolartransistors der Erfindung angegeben, mit den Schritten:

- Bereitstellen eines präparierten Substrates, auf dem entweder ausschließlich aktive Bipolartransistorgebiete oder sowohl aktive Bipolartransistorgebiete also auch aktive CMOS-Gebiete definiert sind,
- Abscheiden einer Hilfsschicht auf dem präparieren Substrat und Öffnen 15 von Fenstern in dieser Hilfsschicht in den aktiven Bipolartransistorgebieten,
- Abscheiden einer epitaxialen Basisschicht,
- Abscheiden einer Isolatorschicht auf der epitaxialen Basisschicht und Ausbilden eines Emitterfensters durch abschnittsweises Entfernen der 20 Isolatorschicht,
- Abscheiden einer Emitterschicht (9) und laterale Strukturierung des Emitters, derart, dass der Emitter ein T-förmiges Querschnittsprofil erhält,

- Ausbildung von Abstandshaltern aus Isolatormaterial an den Seitenflächen des Emitters
- selektiv epitaktisches Abscheiden einer erhöhten Basisanschlusschicht auf den freigelegten Gebieten der epitaxialen Basisschicht unter Ausbildung einer Facette, die unter einem stumpfen Winkel ( $180^\circ - \beta$ ) auf die Oberfläche der epitaxialen Basisschicht stößt,
- Ausbilden eines Abstandshalters aus Isolatormaterial, der die Facette bedeckt.

Dabei wird der Begriff Bipolartransistorgebiet synonym mit dem in der Fachwelt ebenfalls üblichen Begriff „Bipolargebiet“ verwendet. Nachfolgend werden Ausführungsformen beschrieben, deren zusätzliche Merkmale im Zusammenhang mit beiden alternativen Herstellungsverfahren nach dem zweiten oder dritten Aspekt der Erfindung Verwendung finden können.

Ein Ausführungsbeispiel hat die folgenden Schritte:

- 15 - Entfernen der epitaxialen Basisschicht, der erhöhten Basisanschlusschicht und der Hilfsschicht von Kollektoranschlussgebieten der Bipolartransistoren und gegebenenfalls von den CMOS-Gebieten.
- Gegebenenfalls Implantation der Source-, Drain- und Gategebiete der MOS-Transistoren und Ausheilung der Implantationsschäden sowie gemeinsamer Metallisierungsprozess für die Bipolar- und CMOS-Gebiete.
- 20 - Vorzugsweise wird die epitaxiale Basisschicht mit Hilfe eines differentiellen Epitaxieverfahrens hergestellt, derart, dass auf dem aktiven Bipolartransistorgebiet eine einkristalline Schicht und auf Isolationsgebieten ein polykristalline Schicht entsteht. Auf diese Weise wird die gleichzeitige Abscheidung des inneren Basisgebiets in einkristalliner Form und des äußeren Basisgebiets in polykristalliner Form ermöglicht.

Die zweite Basisschicht wird in einem weiteren Ausführungsbeispiel mit Hilfe eines selektiven Epitaxieverfahrens selektiv auf freigelegten Gebieten der ersten Basisschicht abgeschieden. Die zweite Basisschicht wird in den an den Abstandshalter angrenzenden Gebieten vorzugsweise einkristallin abgeschieden.

- 5 Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der Erfindung unter Bezugnahme auf die Figuren:

- Figur 1 zeigt die äußere und innere Basisregion eines Bipolartransistors gemäß dem Stand der Technik in der Draufsicht.  
10 Figur 2 zeigt eine Querschnittsansicht eines Bipolartransistors mit erhöhter Basisanschlussschicht nach bekanntem Stand der Technik.  
Figur 3 zeigt eine Querschnittsansicht eines erfindungsgemäßen Bipolartransistors mit erhöhter Basisanschlussschicht.  
15 Figur 4 zeigt eine Querschnittsansicht des Bipolartransistors der Figur 3 in einer ersten Herstellungsphase nach der Abscheidung der inneren Basisschicht und der anschließenden Abscheidung einer dielektrischen Doppelschicht.  
20 Figur 5 zeigt eine Querschnittsansicht des Bipolartransistors der Figur 3 in einer zweiten Herstellungsphase nach der Öffnung des Emitterfensters und der Abscheidung einer weiteren dielektrischen Schicht.  
Figur 6 zeigt eine Querschnittsansicht des Bipolartransistors der Figur 3 in einer dritten Herstellungsphase nach der Abscheidung des Emitters.

- Figur 7 zeigt eine Querschnittsansicht des Bipolartransistors der Figur 3 in einer vierten Herstellungsphase nach der Strukturierung des Emitters und der Ausbildung von Spacern.
- 5 Figur 8 zeigt eine Querschnittsansicht des Bipolartransistors der Figur 3 in einer fünften Herstellungsphase nach dem selektiven Wachsen der erhöhten Basisanschlusschicht.
- Figur 9 zeigt eine Querschnittsansicht des Bipolartransistors der Figur 3 in einer sechsten Herstellungsphase nach der Strukturierung der Basischicht.
- 10 Figur 10 zeigt eine Querschnittsansicht eines Bipolartransistors, der nach einem alternativen erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt wird, in einer ersten Herstellungsphase nach der Abscheidung der Emitterschicht und einer zusätzlichen Isolatorschicht oberhalb der Emitterschicht.
- 15 Figur 11 zeigt eine Querschnittsansicht des Bipolartransistors der Figur 10 in einer zweiten Herstellungsphase nach der selektiven Abscheidung der erhöhten Basisanschlusschichtschicht.

Nachfolgend werden drei Ausführungsbeispiele näher beschrieben. Beispiel 1 ist ein Bipolartransistor. Beispiel 2 ist ein Verfahren zu Herstellung eines solchen Bipolartransistors. Beispiel 3 ist ein alternatives Herstellungsverfahren.

Beispiel 1:

Figur 3 zeigt in einer Querschnittsansicht die Struktur eines Ausführungsbeispiels des Bipolartransistors der Erfindung. In diesem Beispiel ist ein npn-Transistor mit epitaktischer Basis auf einem hochohmigen, p-leitenden Si-Substrat 1 gefertigt. Die wesentlichen Merkmale der beschriebenen Anord-

nung können auch auf andere Substratdotierungen und auf pnp-Transistoren übertragen werden.

Der npn-Transistor umfasst einen n-leitenden Emitter 9, eine p-leitende Basis 4 und einen n-leitenden Kollektor 17. Der Kollektor ist über ein n-leitendes 5 Gebiet 18 und ein n-leitendes Kollektoranschlussgebiet 19 zum Kontakt geführt. Oberhalb des Kollektorgebietes ist eine erste, epitaxiale Basisschicht 4 angeordnet, die eine p-Dotierung enthält. Insbesondere kann die epitaxiale Basisschicht eine SiGe-Schicht einschließen. Beispielsweise kann die epitaxiale Basisschicht eine Schichtfolge Si/SiGe/Si umfassen. Zusätzlich kann die 10 epitaxiale Basisschicht mit Kohlenstoff dotiert sein. Die epitaxiale Basisschicht kann besonders vorteilhaft durch differentielle Epitaxie hergestellt werden. Dabei wächst die Schicht auf aktiven Gebieten des Substrates einkristallin und auf Isolationsgebieten 2 polykristallin.

Die erste Basisschicht 4 weist einen inneren Basisabschnitt 4a auf. Die lateralen Grenzen des inneren Basisabschnitts 4a sind durch gestrichelte Linien gekennzeichnet, die zugleich die lateralen Grenzen eines um die laterale Erstreckung des Abstandshalters 8 verbreiterten Emittorfensters andeuten. 15

Oberhalb der epitaxialen Basisschicht ist der Emitter 9 angeordnet. Der Emitter 9 besteht aus n<sup>+</sup>-dotiertem Si, welches einkristallin oder polykristallin sein 20 kann.

Der Emitter wird lateral von einer zweiten Basisschicht 12, hier auch als erhöhte Basisanschlusschicht bezeichnet, umgeben, die durch Gebiete 6, 8, 13 aus Isolatormaterial von dem Emitter getrennt ist. Die erhöhte Basisanschlusschicht 12 kann beispielsweise durch selektive Epitaxie hergestellt 25 werden, bei der das Schichtwachstum auf die freigelegte Si-Oberfläche der epitaxialen Basisschicht 4 beschränkt ist. Emitter, Basis und Kollektor sind durch Silizidschichten 14 und Metallkontakte 16 angeschlossen, die durch Isolatorgebiete 15 separiert sind.

Die erhöhte Basisanschlusschicht 12 besteht vorzugsweise aus Silizium, aus SiGe, oder aus einem Schichtstapel aus Si und SiGe. Die erhöhte Basisanschlusschicht 12 ist oberhalb des einkristallinen Bereiches der epitaxialen Basisschicht 4 ebenfalls einkristallin. Die außerhalb der lateralen Grenzen des 5 inneren Basisabschnitts 4a liegenden Abschnitte der ersten, epitaxialen Basisschicht 4 und der zweiten Basisschicht (erhöhten Basisanschlusschicht) 12 bilden eine äußeren Basisabschnitt 4b. Es versteht sich, dass die Schichtstruktur grundsätzlich für die Definition von innerem und äußerem Basisabschnitt keine Rolle spielt. Der äußere Basisabschnitt kann auch aus nur einer 10 oder einer Vielzahl von Schichten bestehen. Wesentlich ist im vorliegenden Zusammenhang, dass der äußere Basisabschnitt in Höhenrichtung eine größere Erstreckung hat, kurz gesagt, dicker ist als der innere Basisabschnitt.

Die Dotierung der erhöhten Basisanschlusschicht 12 ist vom gleichen Leistungstyp wie die der epitaxialen Basisschicht. Die Dotierung kann beispielsweise 15 in-situ während des selektiven Schichtwachstums eingebracht werden. In dem npn-Transistor des vorliegenden Ausführungsbeispiels ist die erhöhte Basisanschlusschicht mit Bor in einer Konzentration oberhalb  $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ , vorzugsweise in einem Konzentrationsbereich von  $2 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  bis  $2 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$  dotiert.

20 Bei der in-situ Dotierung kann es sich auch um eine inhomogene Dotierung handeln, die ein oder mehrere Dotierungsmaxima aufweist.

Die p-Dotierung der erhöhten Basisanschlusschicht kann durch Ionenimplantation erhöht sein. Die Energie der implantierten Ionen wird dabei so gewählt, dass ihre Eindringtiefe auf den Bereich oberhalb des Maximums der Dotierung 25 der epitaxialen Basisschicht 4 beschränkt ist, um eine Erhöhung der Basis-Kollektor-Kapazität zu vermeiden.

Die erhöhte Basisanschlusschicht kann zusätzlich mit Kohlenstoff dotiert sein. Die Kohlenstoffdotierung dient dazu, die Ausdiffusion anderer Dotierstoffe, insbesondere von Bor, aus der erhöhten Basisanschlusschicht in den dar-

unter liegenden inneren Basisabschnitt zu kontrollieren und den Einfluss möglicher Implantationsschäden auf die Diffusion von Dotierstoffen zu unterdrücken.

- Die Kohlenstoffdotierung kann beispielsweise in-situ während des Wachstums der erhöhten Basisanschlusschicht eingebracht werden. Sie kann sich über die gesamte Dicke der erhöhten erstrecken oder auf Teile davon beschränkt Basisanschlusschicht sein. Die Kohlenstoffkonzentration hat einen Wert zwischen  $5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$  und  $5 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ , vorzugsweise zwischen  $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  und  $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ .
- Emitter und erhöhte Basisanschlusschicht 12 sind durch ein Isolatorgebiet voneinander getrennt, das in dem Ausführungsbeispiel aus einem isolierenden Spacer 8, dem verbliebenen Teil einer isolierenden Zwischenschicht 6 und einem weiteren isolierendem Spacer 13 besteht. Die Isolationsgebiete 6, 8 und 13 bestehen aus Siliziumdioxid. Um den Basiswiderstand des Bipolartransistors zu verringern, ist die laterale Erstreckung d der Isolationsschicht 8 an der Grenze zum inneren Basisabschnitt der epitaxialen Basisschicht 4 möglichst gering. Die laterale Erstreckung d des Spacers wird nachfolgend auch als seine Dicke bezeichnet. An der Grenze zur ersten Basisschicht 4 hat der Spacer 8 eine Dicke von 5nm bis 80nm, vorzugsweise von 15nm bis 50nm.

Der Winkel  $\beta$ , der von der Außenkante des Spacers 8 und von der Oberfläche der Basisschicht 4 gebildet wird, ist kleiner als  $90^\circ$ . Vorzugsweise hat der Winkel  $\beta$  einen Wert zwischen  $40^\circ$  und  $75^\circ$ . Der Öffnungswinkel  $\alpha$  der Seitenflächen des Emitters ist größer als  $90^\circ$  und hat vorzugsweise eine Wert zwischen  $100^\circ$  und  $135^\circ$ . Die dadurch erreichte Zunahme der Emitterbreite nach oben hin führt zu einem reduzierten Emitterwiderstand. Dadurch wird eine optimale Verteilung des Basisstroms bei minimaler Basis-Emitter-Kapazität erreicht.

Beispiel 2:

Ein erstes Verfahren zur Herstellung eines Bipolartransistors mit erhöhtem Basisanschlussgebiet wird nun in bezug auf Figur 4 bis 9 erläutert. In den nachfolgenden Figuren werden gleiche Strukturelemente durch gleiche Nummern bezeichnet.

Insbesondere ermöglicht das erfindungsgemäße Verfahren die Herstellung von Hochgeschwindigkeits-Bipolartransistoren in integrierten Bipolar- und BiCMOS-Prozessen.

In dem Ausführungsbeispiel handelt es sich um ein Verfahren zur Herstellung von npn-Bipolartransistoren auf einem p-leitenden Substrat 1. Auf dem Substrat 1 sind aktive Gebiete und Isolationsgebiete 2 strukturiert. Im Bereich des Kollektors des Transistors wurden beispielsweise durch maskierte Ionenimplantation n-leitende Gebiete 18, 19 erzeugt.

In den CMOS-Gebieten werden n- und p-leitende Wannen hergestellt und Gates aus Poly-Silizium strukturiert und mit seitlichen Spacern versehen.

Auf den wie beschrieben strukturierten Si-Scheiben wird eine Hilfsschicht 3 abgeschieden. Bei dieser Hilfsschicht kann es sich insbesondere um einen Schichtstapel verschiedener Materialien, insbesondere aus Siliziumdioxid und Siliziumnitrid, handeln. Die Hilfsschicht 3 wird mit Hilfe einer Lackmaske über den aktiven Gebieten des Bipolartransistors geöffnet (Abb. 4).

Auf den geöffneten aktiven Gebieten des Bipolartransistors wird die Basischicht 4 einkristallin gewachsen. Die epitaktische Basisschicht 4 kann insbesondere eine SiGe-Schicht und eine Dotierung mit Kohlenstoff enthalten. Die p-Dotierung der intrinsischen Basis wird während des Schichtwachstums *in situ* eingebracht. Für die Abscheidung der Basisschicht 4 kann insbesondere ein differentielles Epitaxieverfahren genutzt werden, bei dem auf den freige-

legten Isolationsgebieten 2 und auf der Hilfsschicht 3 eine polykristalline Schicht wächst.

Auf der Basisschicht werden eine weitere Hilfsschicht 5, die aus einer Doppelschicht aus Siliziumdioxid und Siliziumnitrid bestehen kann, und eine Isolatorschicht 6 abgeschieden (Abb. 4). Die Hilfsschicht 5 besteht beispielsweise aus einer Siliziumdioxidschicht mit einer Dicke von 5 nm bis 30 nm und aus einer Siliziumnitridschicht mit einer Dicke von 40 nm bis 150 nm. Bei der Isolatorschicht 6 handelt es sich beispielsweise um eine Siliziumdioxidschicht mit einer Dicke von 50 nm bis 150 nm.

Mit Hilfe einer Lackmaske wird in den Isolatorschichten 5, 6 ein Fenster geöffnet, das die aktive Emitterfläche definiert. Dieses Fenster wird auch als Emitterfenster bezeichnet. Die Strukturierung der Isolatorschicht 6 erfolgt durch reaktives Ionenätzen (Reactive Ion Etching, RIE). Anschließend wird die Lackmaske entfernt und die Hilfsschicht 5 geöffnet, beispielsweise durch ein isotropes Nassätzverfahren. Das Nassätzverfahren ätzt selektiv die Schicht 5 aus Siliziumnitrid, nicht aber die Schicht 6, die aus Siliziumdioxid besteht. Durch das isotrope Ätzen wird die in Abb. 5 gezeigte Aufweitung der Öffnung der Hilfsschicht 5 nach oben hin realisiert.

In einer Ausgestaltung der Erfindung wird die zur Öffnung des Emitterfensters verwendete Lackmaske genutzt, um eine zusätzliche Kollektordotierung 17 selbstjustiert zum Emitterfenster zu implantieren.

In einem weiteren Schritt wird eine Isolatorschicht 7 abgeschieden, die vorzugsweise aus Siliziumdioxid besteht und eine Dicke von 30nm bis 150nm hat (Figur 5). Diese Isolatorschicht wird mittels eines anisotropen RIE-Prozesses zurückgeätzt, wobei innerhalb des geöffneten Emitterfensters Spacer 8 geformt werden (Figur 6).

In einem weiteren Schritt wird der Emitter 9 abgeschieden. Der Emitter besteht vorzugsweise aus Silizium, das in-situ mit einer n<sup>+</sup>-Dotierung versehen wird.

Im Bereich des Emitterfensters kann der Emitter einkristallin oder polykristallin sein. Oberhalb der Emitterschicht wird eine weitere Isolatorschicht 10 abgeschieden, die vorzugsweise aus Siliziumdioxid oder einem Schichtstapel aus Siliziumdioxid und Siliziumnitrid besteht (Figur 6).

- 5 Die Emitterschicht 9 sowie die Isolatorschichten 10 und 6 werden in einem weiteren Schritt über eine Lackmaske strukturiert (Figur 7). Anschließend werden an den Seitenflächen des Emitters Spacer 13 hergestellt, die beispielsweise aus Siliziumdioxid bestehen. Bei der Strukturierung der Emitterschicht und bei der anschließenden Spacerätzung kann die Hilfsschicht 5 als Stoppschicht genutzt werden.
- 10

Anschließend wird die Hilfsschicht 5 entfernt. Dafür wird beispielsweise ein selektiver Nassätzprozess benutzt, der die aus Siliziumnitrid bestehende Hilfsschicht 5 entfernt aber nicht die aus Siliziumdioxid gebildete Umhüllung 6, 8, 10, 11 des Emitters.

- 15 Auf der freigelegten Oberfläche der Basisschicht 4 wird mittels selektiver Epitaxie die erhöhte Basisanschlusssschicht 12 abgeschieden (Figur 8). Insbesondere erfolgt die selektive Abscheidung auch unter den überhängenden Gebieten des Emitters nicht aber auf den Isolatorschichten 6, 8, 10, 11, die den Emitter umhüllen. Dadurch wird eine Selbstjustierung der erhöhten Basis-
- 20 anschlusssschicht 12 zum Emitter 9 realisiert, wobei der Abstand beider Schichten durch die Form des Spacers 8 definiert wird.

- 25 In einem weiteren Schritt werden die Basisschichten 4 und 12 mit Hilfe einer weiteren Lackmaske von den Kollektoranschlussgebieten und von den CMOS-Gebieten vollständig entfernt. Dafür kann ein RIE-Prozess genutzt werden, der auf der Hilfsschicht 3 stoppt. Anschließend wird die Hilfsschicht 3 entfernt. Die CMOS-Gebiete befinden sich damit wieder in dem gleichen Zustand wie vor der Abscheidung der Hilfsschicht 3.

In einem BiCMOS-Prozess erfolgt in den folgenden Prozessschritten die Dotierung der Source-Drain-Gebiete der MOS-Transistoren entsprechend dem bekannten Stand der Technik.

5 In einer Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens wurden die Isolatorschicht 10 und die Spacer 11 durch nasschemische Prozessschritte von dem Emitter entfernt. In dieser Ausgestaltung können an den Seitenflächen der Emitter- und der Basisschicht weiter Spacer 13 hergestellt werden (Figur 9).

10 In einem weiteren Schritt werden die freigelegten Halbleiteroberflächen der Basis-, Emitter- und Kollektorgebiete der Bipolartransistoren gemeinsam mit den Source, Drain- und Gate-Gebieten der MOS-Transistoren siliziert (14 in Abb. 3). Bipolar- und MOS-Transistoren werden anschließend in einem gemeinsamen Metallisierungsprozess entsprechend dem bekannten Stand der Technik kontaktiert.

15 Beispiel 3:

Ein zweites Verfahren zur Herstellung eines Bipolartransistors mit erhöhtem Basisanschlussgebiet unterscheidet sich von dem in Beispiel 2 beschriebenen Verfahren im wesentlichen dadurch, dass die erhöhte Basisanschlusssschicht nicht selbstjustiert zu dem Emitterfenster abgeschieden wird. Dieses Verfahren wird nun in Bezug auf Figur 10 und 11 erläutert.

Bis zur Abscheidung der Basisschicht 4 ist das Verfahren identisch zu dem in Beispiel 2 beschriebenen Verfahren. Anschließend wird auf der Basisschicht 4 eine Isolatorschicht 20 abgeschieden. Diese Isolatorschicht besteht vorzugsweise aus Siliziumdioxid und hat vorzugsweise eine Dicke zwischen 40nm und  
25 150nm.

In der Isolatorschicht 20 wird über eine Lackmaske ein Emitterfenster strukturiert. In einem weiteren Schritt wird der Emitter 9 abgeschieden. Der Emitter

besteht vorzugsweise aus Silizium, das in-situ mit einer n<sup>+</sup>-Dotierung versehen wird. Im Bereich des Emitterfensters kann der Emitter einkristallin oder polykristallin sein. Oberhalb der Emitterschicht wird in einer Ausgestaltung der Erfindung eine Isolatorschicht 21 abgeschieden die vorzugsweise aus Siliziumdioxid besteht (Figur 10).

Die Emitterschicht 9 sowie die Isolatorschicht 10 werden in einem weiteren Schritt über eine Lackmaske strukturiert. Anschließend werden an den Seitenflächen des Emitters Spacer 22 hergestellt, die vorzugsweise aus Siliziumnitrid oder aus Siliziumdioxid bestehen. Um einen minimalen Basiswiderstand des Transistors zu realisieren, muss die Dicke dieses Spacers minimiert werden. Die Dicke des Spacers beträgt erfindungsgemäß 5nm bis 50nm, vorzugsweise 5nm bis 20nm.

Die Oberfläche der Basisschicht 4 wird in den Bereichen außerhalb des Emitters durch Nassätzen freigelegt. Auf der freigelegten Oberfläche der Basisschicht 4 wird mittels selektiver Epitaxie die erhöhte Basisanschlusschicht 23 abgeschieden (Figur 11). Dafür kann insbesondere ein selektives Epitaxieverfahren eingesetzt werden, welches an der Begrenzung der freigelegten Silizium-Oberfläche zur Ausbildung einer Facette mit einem spitzen Winkel β führt (Figur 11).

Die beschriebene Facette der erhöhten Basisanschlusschicht 23 wird in einem der folgenden Prozessschritte ganz der teilweise durch einen weiteren Abstandshalter aus Isolatormaterial bedeckt (nicht dargestellt). Dadurch wird zwischen Emitter und erhöhter Basisanschlusschicht eine Gestaltung des Isolationsgebietes realisiert, bei der die laterale Erstreckung (d) des Abstandshalters ausgehend von seiner Grenzfläche zum inneren Basisabschnitt mit zunehmender Höhe über dem inneren Basisabschnitt zunimmt..

Nach der Abscheidung der erhöhten Basisanschlusschicht wird das Verfahren wie in Beispiel 2 beschrieben fortgesetzt. Insbesondere kann das Verfahren zur Herstellung von Hochgeschwindigkeits-Bipolartransistoren mit erhöhter

Basisanschlusschicht sowohl in Bipolar- als auch in BiCMOS-Prozessen angewendet werden.

In einer weiteren Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens für BiCMOS-Prozesse werden durch einen selektiven Epitaxieschritt sowohl die erhöhte Basisanschlusschicht als auch erhöhte Source-Drain-Gebiete von MOS-Transistoren hergestellt. Insbesondere wird die in-situ  $p^+$ -dotierte erhöhte Basisanschlusschicht des npn-Bipolartransistors auch auf den freigelegten Source- und Draingebieten der PMOS-Transistoren abgeschieden. Durch derartig erhöhte Source-Drain-Gebiete werden reduzierte Anschlusswiderstände von Source und Drain bei gleichzeitiger Reduzierung der Eindringtiefe der Source-Drain-Gebiete in das Substrat erreicht.

In dieser Ausgestaltung der Erfindung wird vor der Abscheidung der äußeren Basisschicht die intrinsische Basisschicht 4 von den CMOS-Gebieten entfernt, auf denen die selektive Abscheidung erfolgen soll. Weiterhin wird die Hilfschicht 3 von diesen Gebieten entfernt. In einem anschließenden Schritt erfolgt das selektive Abscheiden der erhöhten Basisanschlusschicht und der erhöhten Source-Drain-Gebiete auf der freigelegten Oberfläche der intrinsischen Basisschicht 4 und auf den in den CMOS-Gebieten freigelegten Si-Bereichen.

Patentansprüche

## 1. Bipolartransistor auf einem Substrat, umfassend

eine Basis (4, 12) mit einem inneren Basisabschnitt (4a) und einem äußeren Basisabschnitt (4b), der an den inneren Basisabschnitt (4a) in zur Substratoberfläche paralleler, lateraler Richtung angrenzt und in einer senkrecht zur Substratoberfläche weisenden Höhenrichtung eine größere Erstreckung hat als der innere Basisabschnitt (4a), wobei die Basis eine erste, epitaktische Basisschicht (4) und eine zweite, auf der ersten aufliegende Basisschicht (12) enthält und die zweite Basisschicht (12) im lateralen Bereich des inneren Basisabschnitts (4a) zur Bildung eines Emitterfensters (9, 4a) geöffnet ist,  
5 einen Emitter (9) mit einem T-förmigem Querschnittsprofil, der vom äußeren Basisabschnitt (4b) lateral durch einen Abstandshalter (8) aus Isolatormaterial getrennt ist und dessen dem vertikalen T-Balken entsprechender Abschnitt mit seinem unteren Ende in Höhenrichtung an den inneren Basisabschnitt (4a) angrenzt,  
10 bei dem unterhalb eines dem horizontalen T-Balken entsprechenden Abschnitt des Emitters (9) die laterale Erstreckung (d) des Abstandhalters (8) ausgehend von seiner Grenzfläche zum inneren Basisabschnitt (4a) zunimmt,  
15 wobei eine von Emitter (9) und Abstandshalter (8) gebildete erste Grenzfläche unter einem ersten, entweder rechten oder stumpfen Winkel ( $\alpha$ ) auf eine von Emitter und innerem Basisabschnitt gebildete zweite Grenzfläche stößt und  
20 eine vom Abstandshalter (8) und dem äußeren Basisabschnitt (4b) gebildete dritte Grenzfläche auf die zweite Grenzfläche unter einem zweiten stumpfen Winkel stößt, der größer ist als der erste Winkel.  
25

2. Bipolartransistor nach Anspruch 1, bei dem die minimale laterale Erstreckung (d) des Abstandshalters (8) an der Grenzfläche zum inneren Basisabschnitt (4a) zwischen 5 und 80 nm beträgt.
3. Bipolartransistor nach Anspruch 1, bei dem die minimale laterale Erstreckung (d) des Abstandshalters (8) an der Grenzfläche zum inneren Basisabschnitt (4a) zwischen 10 und 60 nm beträgt.  
5
4. Bipolartransistor nach Anspruch 1, bei dem die minimale laterale Erstreckung (d) des Abstandshalters (8) an der Grenzfläche zum inneren Basisabschnitt (4a) zwischen 15 und 50 nm beträgt.
- 10 5. Bipolartransistor nach Anspruch 1, bei dem der stumpfe Winkel ( $\alpha$ ) zwischen  $100^\circ$  und  $135^\circ$  beträgt.
6. Bipolartransistor nach Anspruch 1 oder 5, bei dem der zweite stumpfe Winkel  $180^\circ - \beta$  beträgt, wobei  $\beta$  zwischen  $40^\circ$  und  $75^\circ$  beträgt.
- 15 7. Bipolartransistor nach einem der vorstehenden Ansprüche, mit einer höheren Dotierstoffkonzentration im äußeren Basisabschnitt als im inneren Basisabschnitt.
- 20 8. Bipolartransistor nach Anspruch 7, bei dem die zweite Basisschicht (12) oder beide Basisschichten im äußeren Basisabschnitt (4b) eine im Vergleich zum inneren Basisabschnitt (4a) erhöhte Dotierstoffkonzentration aufweisen, wobei die höhere Dotierstoffkonzentration auf einen Höhenabschnitt oberhalb eines Maximums der Dotierstoffkonzentration im inneren Basisabschnitt (4a) beschränkt ist.
9. Bipolartransistor nach einem der vorstehenden Ansprüche bei dem der innere Basisabschnitt oder der äußere Basisabschnitt oder beide Basisabschnitte zusätzlich mit Kohlenstoff dotiert sind.  
25

10. Bipolartransistor nach Anspruch 9, bei dem die Kohlenstoffkonzentration zwischen  $5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$  und  $5 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$  beträgt.
11. Bipolartransistor nach Anspruch 10, bei dem die Kohlenstoffkonzentration  $1 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  bis  $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$  beträgt.
- 5 12. Bipolartransistor nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die zweite Basisschicht (12) eine Dotierstoffkonzentration zwischen  $2 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$  und  $2 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$  aufweist.
- 10 13. Bipolartransistor nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem die erste Basisschicht (4) oder die zweite Basisschicht (12) oder beide eine Silizium-Germanium-Legierung enthalten.
14. Bipolartransistor nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem der äußere Basisabschnitt (12) den Emitter (9) lateral nur teilweise umgibt.
- 15 15. Bipolartransistor nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem der dem horizontalen T-Balken entsprechende Abschnitt des Emitters durch einen zweiten Abstandshalter in Form einer Isolatorschicht vom darunter liegenden äußeren Basisabschnitt getrennt ist.
- 20 16. Bipolartransistor nach Anspruch 15, bei dem die lateralen Enden des dem horizontalen T-Balken entsprechenden Abschnitts des Emitters durch einen dritten Abstandshalter aus Isolatormaterial von dem lateral unterhalb angrenzenden äußeren Basisabschnitt getrennt ist.
17. Bipolartransistor nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem das Isolatormaterial des Abstandshalters (8)  $\text{SiO}_2$  ist.
18. Verfahren zur Herstellung eines Bipolartransistors nach einem der vorstehenden Ansprüche, mit den Schritten:

Abscheiden eines Schichtstapels auf einer epitaxialen Basisschicht, der mindestens eine später zu entfernende Hilfsschicht (5) und eine erste Isolatorschicht (6) enthält,

5 Öffnung des Emitterfensters durch abschnittsweises Entfernen des Schichtstapels,

Abscheiden einer zweiten Isolatorschicht (7) und

10 Strukturieren der zweiten Isolatorschicht (7), derart, dass am Rand des Emitterfensters ein Abstandshalter (8) aus Isolatormaterial entsteht, dessen laterale Erstreckung (d) ausgehend von seiner Grenzfläche zur epitaxialen Basisschicht (4) mit zunehmender Höhe über der epitaxialen Basisschicht (4) zunimmt,

15 Abscheiden einer Emitterschicht (9), im Emitterfenster und auf der zweiten Isolatorschicht (7) sowie Ausbildung eines im Querschnittsprofil T-förmigen Emitters durch laterale Strukturierung der Emitterschicht sowie Ausbildung von Spacern (11) aus Isolatormaterial an den Seitenflächen des Emitters,

Freilegen der Halbleiteroberfläche der Basisschicht (4) in den lateralen Bereichen des äußeren Basisabschnitts (4b) und Abscheiden einer erhöhten Basisanschlusschicht auf diesen Gebieten,

20 wobei die in den letzten drei Absätzen genannten Schritte so durchgeführt werden, dass eine von Emitter (9) und Abstandshalter (8) gebildete erste Grenzfläche unter einem ersten, entweder rechten oder stumpfen Winkel ( $\alpha$ ) auf eine von Emitter und innerem Basisabschnitt gebildete zweite Grenzfläche stößt und

25 eine vom Abstandshalter (8) und der erhöhten Basisanschlusschicht im äußeren Basisabschnitt (4b) gebildete dritte Grenzfläche auf eine von Ab-

standshalter und innerem Basisabschnitt gebildete die zweite Grenzfläche unter einem zweiten stumpfen Winkel stößt, der größer ist als der erste Winkel.

19. Verfahren nach Anspruch 18, mit den folgenden Schritten bis zum Schritt  
5 des Ausbildens des Emitterfensters:

Bereitstellung eines präparierten Substrates (1), auf dem mindestens ein aktives Bipolartransistorgebiet und optional zusätzlich mindestens ein aktives CMOS-Gebiet definiert ist,

Abscheiden einer Hilfsschicht (3) auf dem präparieren Subrat (1) und  
10 Öffnen eines Fensters in der Hilfsschicht (3) über dem aktiven Bipolartransistorgebiet,

Abscheiden einer epitaxialen Basisschicht (4), in die eine Basisdotierung  
in-situ eingebracht wird.

20. Verfahren zur Herstellung eines Bipolartransistors nach einem der An-  
sprüche 1 bis 17, mit den Schritten:  
15

Bereitstellen eines präparierten Substrates, auf dem entweder ausschließlich aktive Bipolartransistorgebiete oder sowohl aktive Bipolartransistorgebiete also auch aktive CMOS-Gebiete definiert sind,

Abscheiden einer Hilfsschicht (3) auf dem präparieren Subrat und Öff-  
20 nen von Fenstern in dieser Hilfsschicht in den aktiven Bipolartransistorge-  
bieten,

Abscheiden einer epitaxialen Basisschicht (4),

Abscheiden einer Isolatorschicht (20) auf der epitaxialen Basisschicht (4) und Ausbilden eines Emitterfensters durch abschnittsweises Entfernen der Isolatorschicht (20),

Abscheiden einer Emitterschicht (9) und laterale Strukturierung des Emitters, derart, dass der Emitter ein T-förmiges Querschnittsprofil erhält

Ausbildung von Abstandshaltern (22) aus Isolatormaterial an den Seitenflächen des Emitters

selektiv epitaktisches Abscheiden einer erhöhten Basisanschlusschicht (23) auf den freigelegten Gebieten der epitaxialen Basisschicht (4) unter Ausbildung einer Facette, die unter einem stumpfen Winkel ( $180^\circ - \beta$ ) auf die Oberfläche der epitaxialen Basisschicht stößt,

Ausbilden eines Abstandshalters aus Isolatormaterial, der die Facette bedeckt.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis 20, mit folgenden Schritten nach dem Abscheiden der erhöhten Basisanschlusschicht (12, 23):

Entfernen der epitaxialen Basisschicht (4), der erhöhten Basisanschlusschicht (12) und der Hilfsschicht (3) von Kollektoranschlussgebieten der Bipolartransistoren und gegebenenfalls von den CMOS-Gebieten.

Gegebenfalls Implantation von Source-, Drain- und Gategebieten zur Bildung von MOS-Transistoren und Ausheilung von Implantationsschäden sowie

Durchführung eines Metallisierungsprozesses für die Bipolar- und gegebenenfalls zugleich auch für die CMOS-Gebiete.

22. Verfahren nach Anspruch 18 oder 21, bei dem die epitaxiale Basisschicht (4) mit Hilfe eines differentiellen Epitaxieverfahrens hergestellt wird, derart, dass auf dem aktiven Bipolartransistorgebiet eine einkristalline Schicht und auf Isolationsgebieten ein polykristalline Schicht entsteht.
- 5 23. Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis 22, bei dem die zweite Basisschicht (12) mit Hilfe eines selektiven Epitaxieverfahrens selektiv auf freigelegten Gebieten der ersten Basisschicht (4) abgeschieden wird.
- 10 24. Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis 23, bei dem die zweite Basisschicht (12) in den an den Abstandshalter (8) angrenzenden Gebieten einkristallin abgeschieden wird.
26. Verfahren nach einem der Ansprüche 18 bis 24, bei dem die zweite Basisschicht (12) während der Abscheidung in-situ mit einer Dotierung versehen wird, die vom gleichen Leitungstyp ist wie die Dotierung der inneren Basis.

1/6

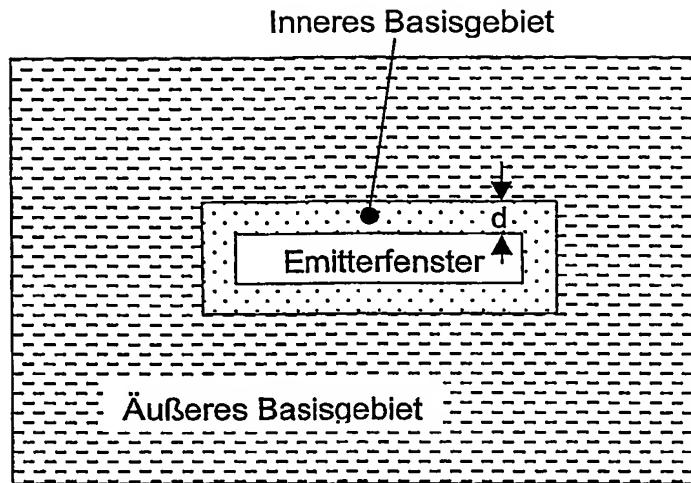


Fig. 1  
Stand der Technik

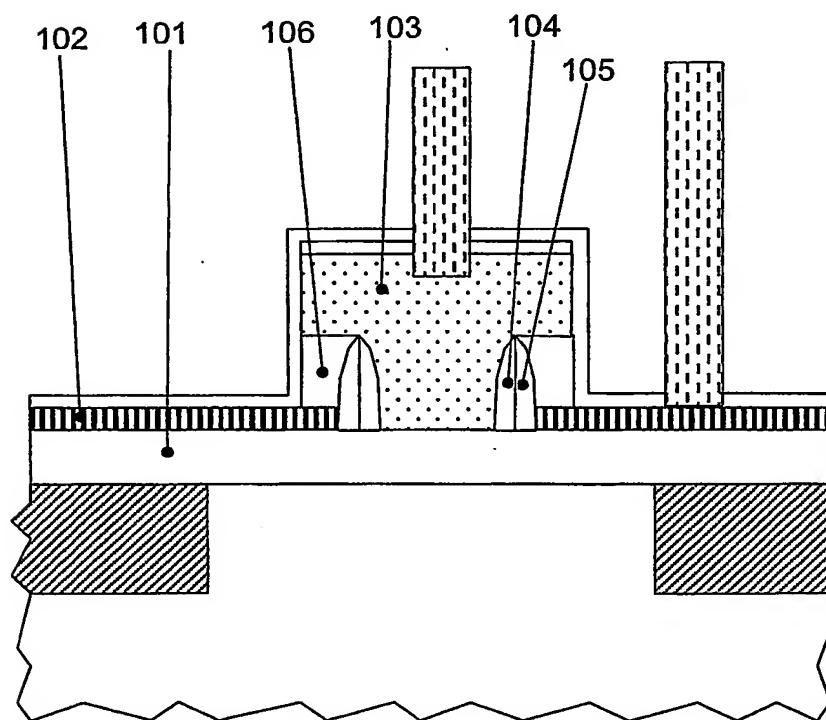


Fig. 2  
Stand der Technik

2/6

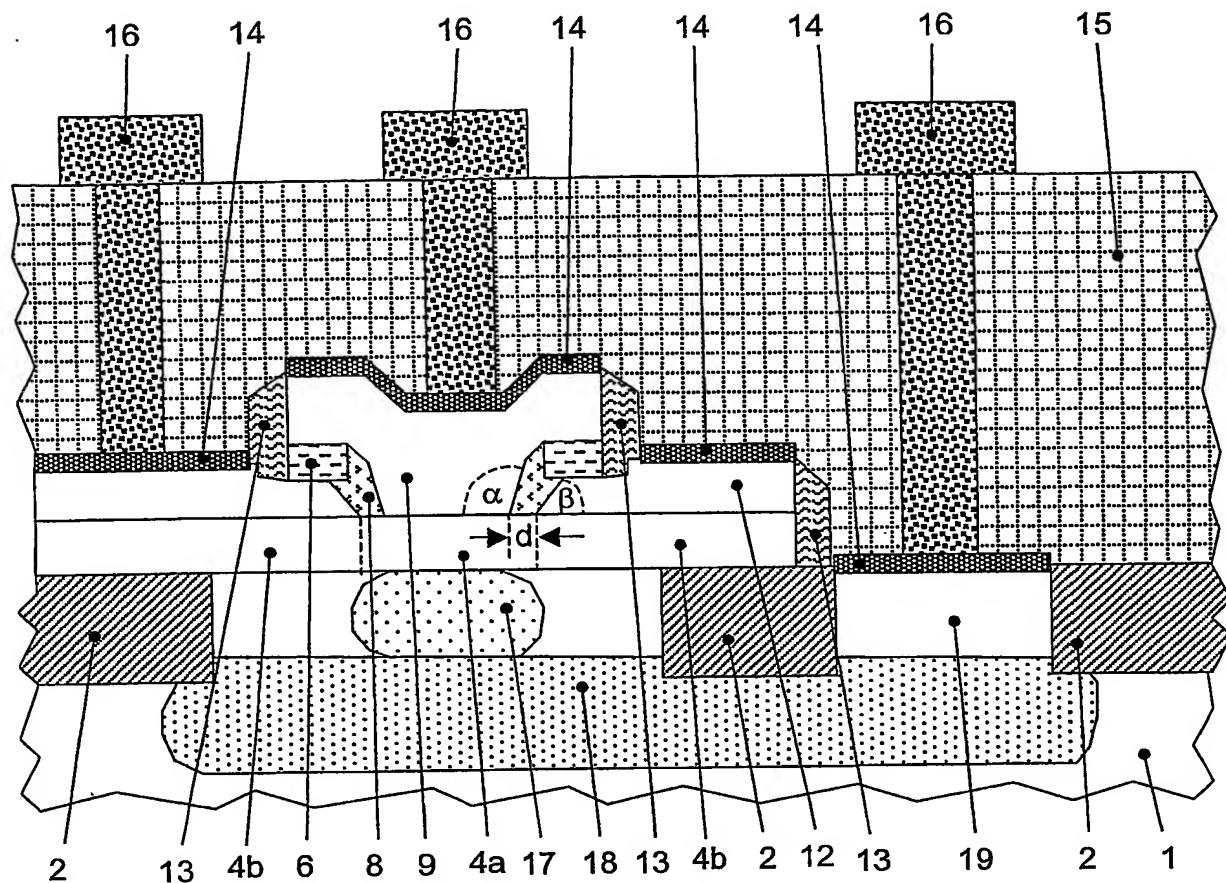


Fig. 3

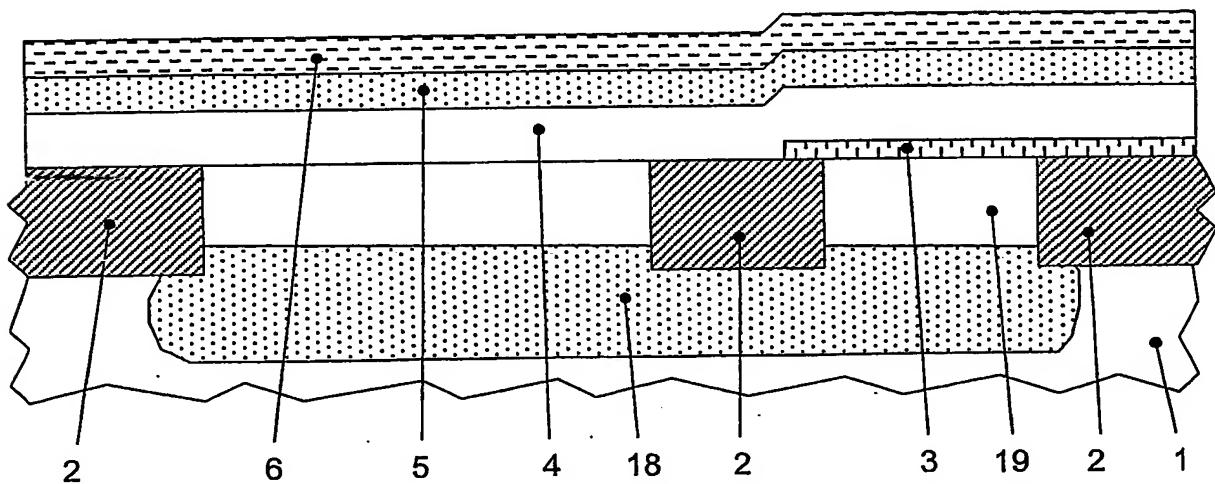


Fig. 4

3/6

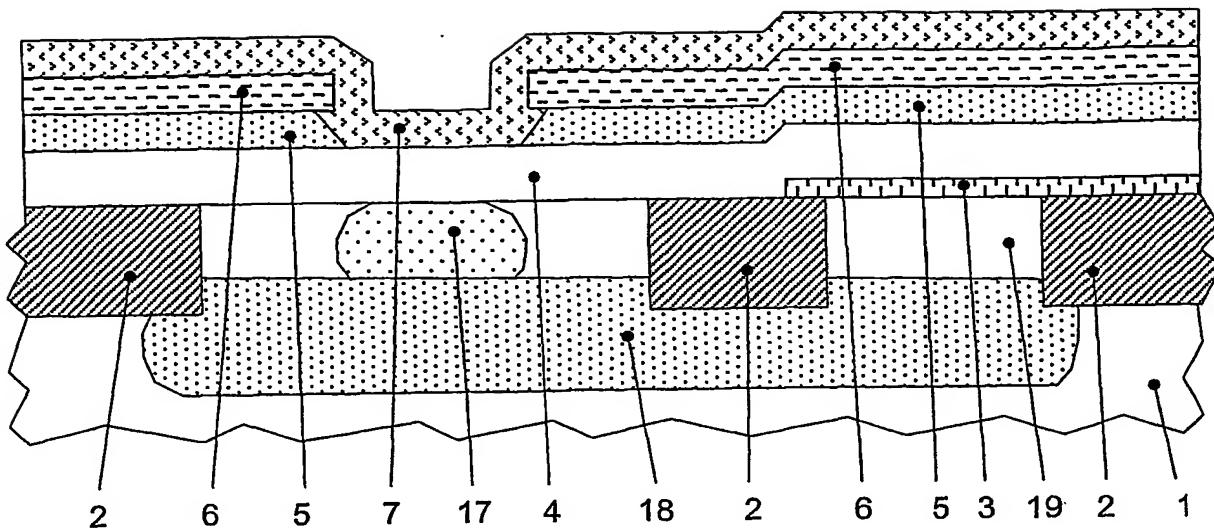


Fig. 5

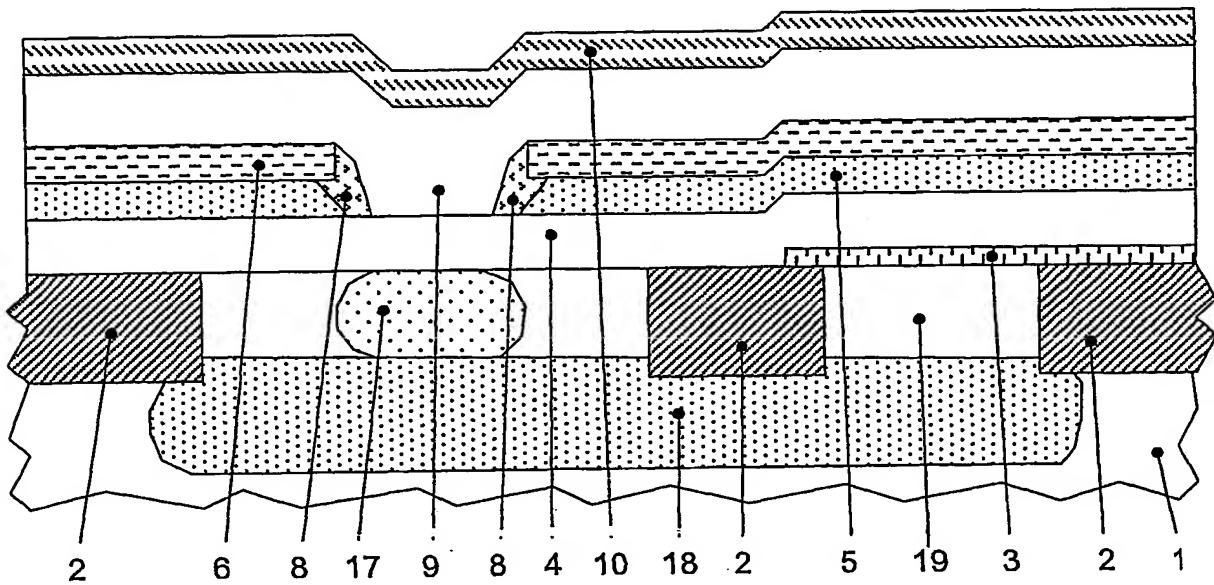


Fig. 6

4/6

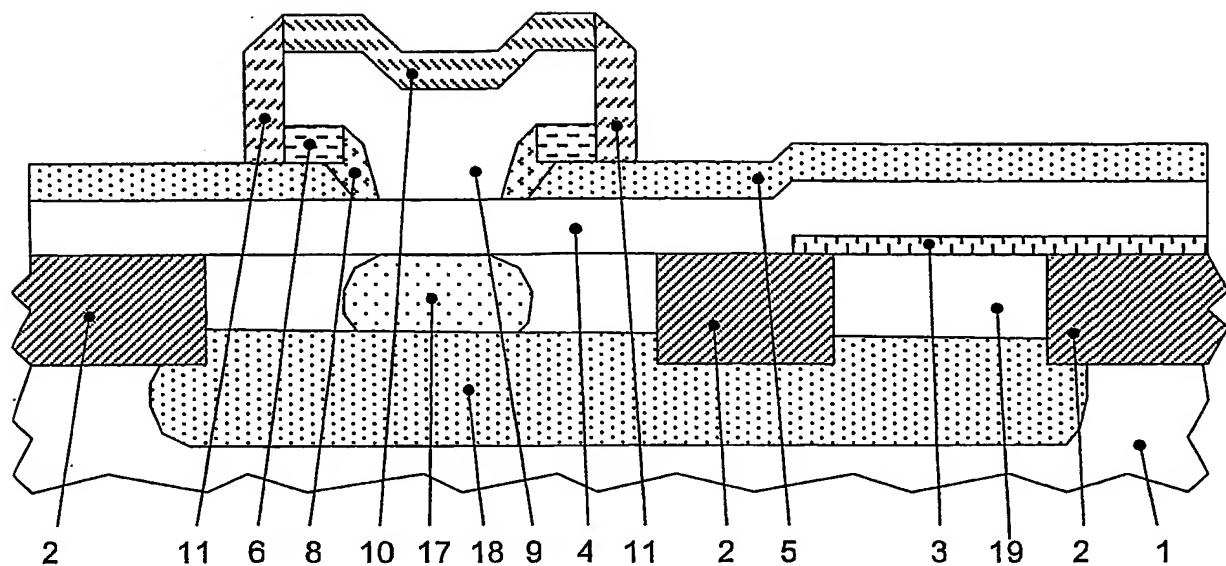


Fig. 7

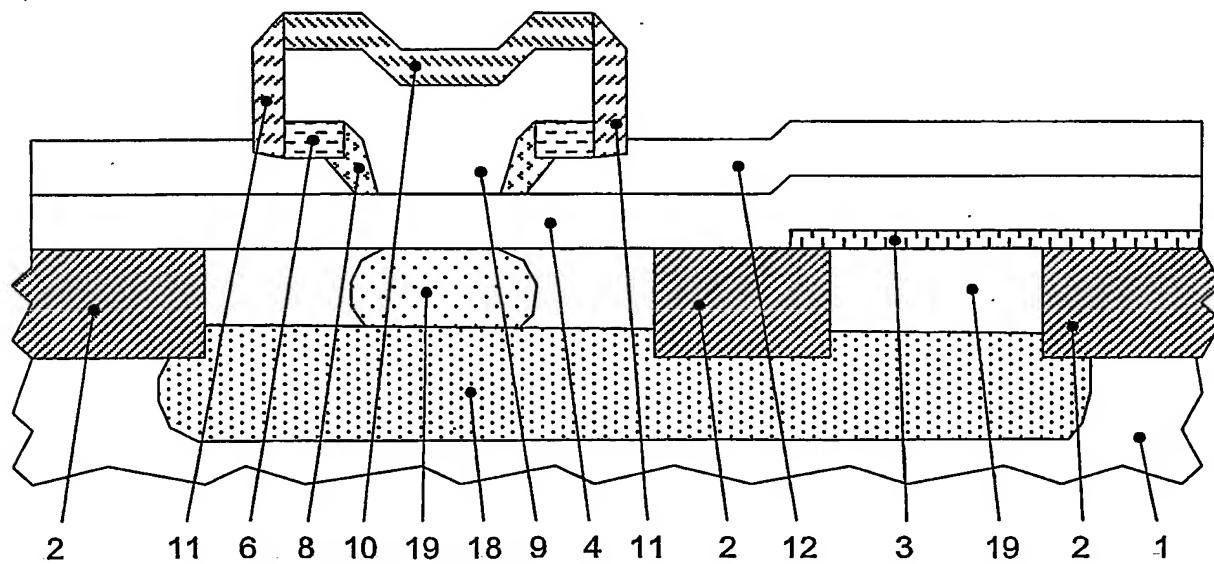


Fig. 8

5/6

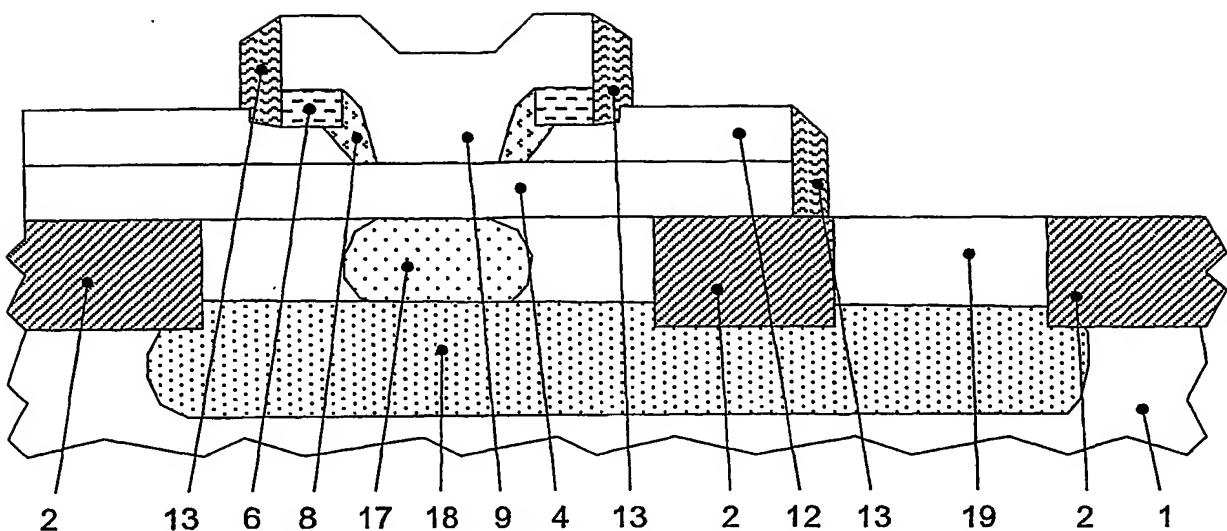


Fig. 9

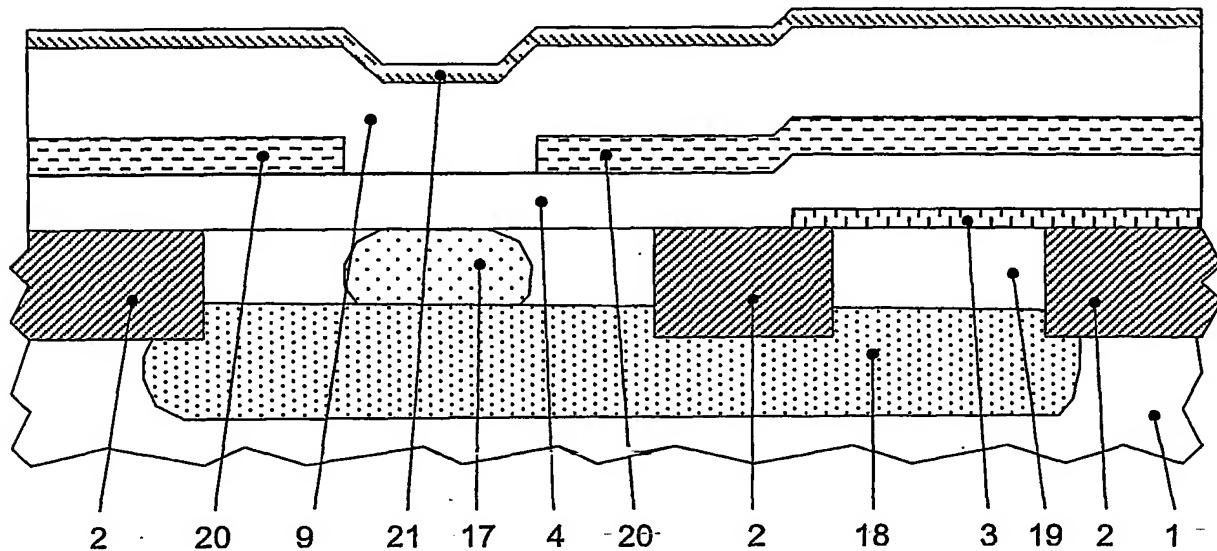


Fig. 10

6/6

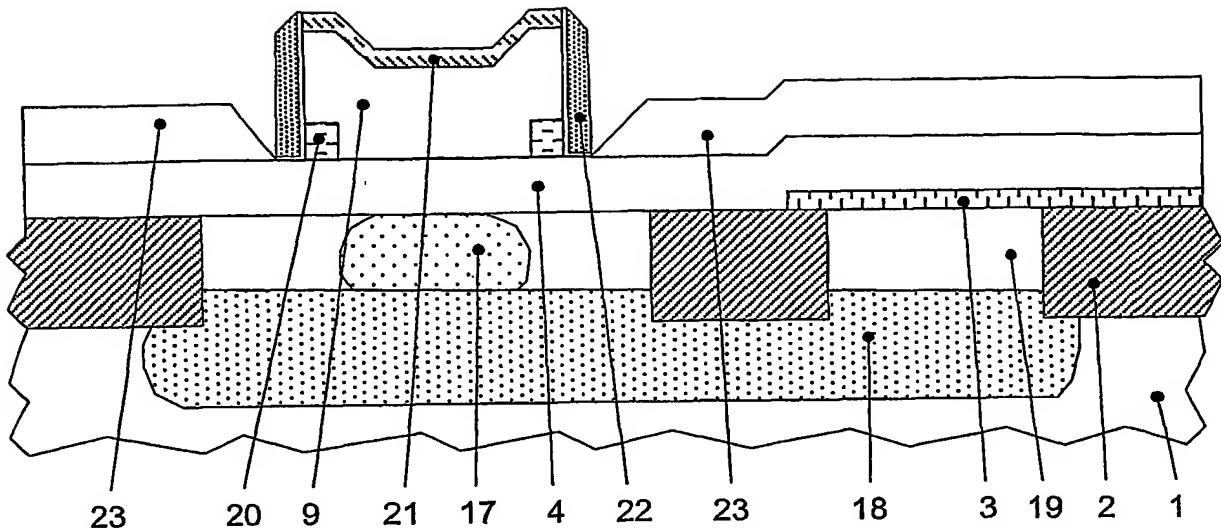


Fig. 11